(上接 D11 版)

截至 2022 年 12 月 31 日止,公司与同行业可比公司借款情况如下:

单位:万元

项目	分类	长电科技	华天科技	通富微电	甬矽电子	晶方科技	气派科技
短期借款	信用借款	67,925.55	210,755.79	310,600.94	55,174.33	–	–
	质押借款	20,893.80	–	–		1,055.17	–
	保证借款	28,546.80	620.00	112,506.83	20,199.96	–	–
	抵押并保证借款					–	25,070.00
	票据贴现借款	–	–	–		–	–
	小计	117,366.14	211,375.79	423,107.76	75,374.29	1,055.17	25,070.00
	信用借款占短期借款比例	57.87%	99.71%	73.41%	73.20%	0.00%	0.00%
长期借款	信用借款	218,570.50	291,115.95	276,349.50	29,900.00	–	–
	质押借款	14,874.64	–	–		–	–
	抵押借款	18,804.42	92,490.00	91,038.92	625.07	340.30	–
	保证借款	322,053.00	100,071.14	148,723.81	31,481.98	–	10,784.00
	抵押并保证借款	–	–	130,198.64	46,407.93	–	–
	抵押、质押并保证借款	–	–	116,763.18	108,414.99	–	–
	小计	574,302.56	483,677.09	763,074.05	27.58%	340.30	10,784.00
	信用借款占长期借款比例	38.06%	60.19%	36.22%		0.00%	0.00%
一年内到期的长期借款	信用借款	–	–	79,850.00		–	–
	抵押借款	–	–	19,675.00		–	–
	保证借款	–	–	32,200.00		–	716.00
	抵押并保证借款	–	–	8,879.49		–	–
	抵押、质押并保证借款	–	–	19,904.33		–	–
	未按露明细分类	302,167.90	218,562.36	–	57,109.86	10,007.61	–
	小计	302,167.90	218,562.36	160,508.82	57,109.86	10,007.61	716.00
	信用借款占 1 年内到期的长期借款比例	不适用	不适用	49.75%	0.00%	0.00%	0.00%
信用借款合计		286,496.05	501,871.75	666,800.43	85,074.33	–	–
扣除未披露明细分类的借款合计		691,668.70	695,052.88	1,346,690.63	183,789.28	1,395.47	36,570.00
信用借款占扣除未披露明细分类的借款合计比例		41.42%	72.21%	49.51%	46.29%	0.00%	0.00%

截至 2022 年 12 月 31 日止,公司取的银行授信额度为 138,700.00 万元,已经使用的额度为 55,906.31 万元。公司借款类型为保证贷款、抵押并保证贷款。

截至 2022 年 12 月 31 日止,同行业可比公司长电科技、华天科技、通富微电和甬矽电子信用借款占扣除未披露明细分类的借款合计的比例分别为 41.42%、72.21%、49.51%和 46.29%。同行业可比公司晶方科技不存在信用借款。

公司一直不存在信用借款,与同行业可比公司晶方科技相同。与同行业可比公司如:长电科技、华天科技、通富微电和甬矽电子存在差异,主要原因:(1)长电科技、华天科技和通富微电因上市时间早,资产规模大,营业收入高,公司信誉及声望高,获取银行信用借款存在较大优势;(2)各银行对公司提供贷款方式的延续性,公司成立以来,与合作银行的借款方式一直是采用抵押借款、保证借款等方式。

因此,公司不存在信用贷款,具有合理性。

(三)结合公司经营性现金流变动趋势,日常生产经营现金需求、短期借款及一年内到期的长期借款到期情况、融资渠道及融资成本等,分析公司的流动性风险,并予以充分提示

2022 年至 2023 年 3 月末,气派科技各季度的经营活动产生的现金流净额情况如下:

单位:万元

项目	2022 年第一季度	2022 年第二季度	2022 年第三季度	2022 年第四季度	2023 年第一季度
经营活动产生的现金流净额	4,298.25	−2,823.09	−6,495.55	−2,382.98	−1,276.37
经营活动产生的现金流净额变动金额		−7,121.34	−3,672.46	4,112.57	1,106.61
变动比例		−165.68%	−130.09%	63.31%	46.44%

公司通过积极促进销售,加强应收账款管理、积极催收应收账款、加强生产成本控制等措施,提高经营活动产生的现金流净额。2022 年第四季度开始,公司经营活动产生的现金流净额逐步转好,并保持增长趋势。

截至 2022 年 12 月 31 日止,公司借款金额为 36,570.00 万元,其中短期借款金额为 25,070.00 万元,一年以内到期的长期借款金额为 716.00 万元。上述短期借款及一年到期的长期借款的到期情况如下:

单位:万元

项目	2023 年第一季度	2023 年第二季度	2023 年第三季度	2023 年第四季度	合计
短期借款到期金额	3,880.00	3,700.00	8,000.00	9,490.00	25,070.00
一年内到期的长期借款到期金额	54.00	254.00	54.00	354.00	716.00
合计	3,934.00	3,954.00	8,054.00	9,844.00	25,786.00

截止至 2022 年 12 月 31 日的短期借款和一年内到期的长期借款合计在 2023 年内到期金额为 25,786.00 万元。前述短期借款及长期借款,公司的银行授信额度可足额覆盖。公司融资渠道主要以金融机构贷款为主,短期借款的融资成本约为 3%-3.5%的借款利率区间,中长期借款的融资成本约为 4%-4.5%的借款利率区间。

截止至 2022 年 12 月 31 日,公司不受限的货币资金余额为 10,835.59 万元,其中募集资金约为 3,753.20 万元。2022 年第四季度开始,公司经营活动产生的现金流净额逐步转好,并保持增长趋势,经营活动产生的现金流预计未来将转正,带来正向现金流。公司自成立以来,未出现逾期未还贷款的情况,信贷记录及声誉好,长年与各金融机构保持良好合作关系。截止至 2022 年 12 月 31 日,公司获取的银行授信额度为 138,700.00 万元,已经使用的额度为 55,906.31 万元,剩余 82,793.69 万元银行授信额度,剩余授信额度充足,流动性压力较小。因此,公司流动性风险较低,整体风险可控。

针对公司有息负债的相关风险,公司在年度报告“四、风险因素”之“(五)财务风险”中补充披露如下:

“有息负债风险

截止 2022 年 12 月 31 日,公司有息负债余额 36,570.00 万元,其中短期借款金额为 25,070.00 万元,一年以内到期的长期借款金额为 716.00 万元,公司有息负债余额较大,且公司 2022 年度经营活动产生的现金流净额下降较大且为负值。若未来银行信贷政策收紧或公司经营活动现金流得不到改善,可能造成公司流动资金紧张,公司有息负债偿付存在一定压力,对公司经营带来不利影响。”

(四)请公司说明在存在大额有息负债的前提下,进行股份回购的原因及合理性

1、回购股份是响应政策号召,维护股价稳定及股东利益的具体措施

2018 年 11 月,证监会、财政部及国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》,指出“上市公司股份回购是国际通行的公司实施并购重组、优化治理结构、稳定股价的必要手段,已是资本市场的一项基础性制度安排。上市公司要切实增强投资者回报意识,充分有效运用法律规定的股份回购方式,积极回报投资者”,鼓励上市公司依法回购股份用于股权激励及员工持股计划。

2022 年 10 月,证监会就修订《上市公司股份回购规则》公开征求意见,指出支持鼓励上市公司依法实施股份回购,积极维护公司投资价值和中小股东权益,将更好顺应市场实际和公司需求,进一步提升回购的制度包容性和实施便利性。

公司自 2021 年 6 月以来的上市第一年、一段时期内公司股价呈现下降趋势,处于较低水平,2022 年 7 月 25 日,公司股票收盘价为 25.00 元/股,市净率仅为 2.67 倍,市盈率仅为 19.74 倍,公司股价处于较低水平。为响应政策号召,增强投资者信心,维护公司市场价值及股东利益,同时为了实施股权激励及员工持股计划。经公司董事长、总经理 2022 年 7 月 25 日提议,并经 2022 年 8 月 4 日召开的第四届董事会第二次会议审议,通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2、回购股份是实施股权激励或员工持股计划建立长效激励机制的具体路径

半导体行业是技术密集型、人才密集型行业,经过多年积累,气派科技已构建起一支在行业拥有较强竞争力的核心人才队伍,但与同行业上市公司,公司经营规模较小、技术水平还在追赶阶段,在吸引和留住优秀人才方面不具竞争优势,股权激励或员工持股计划是公司建立长效激励机制的有力工具。

自 2021 年 6 月上市以来,公司尚未对董事、高级管理人员和核心员工等实施股权激励。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可,为建立、完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购,回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,是建立健全员工激励机制的具体路径。

此外,通过回购股份实施股权激励或员工持股计划也是半导体行业的通行做法,如通富微电、芯海科技、韦尔股份、普冉股份等半导体企业均实施了股份回购,用于员工持股或股权激励。

3、回购股份规模较小,不存在过度消耗公司资金的情形

2022 年 8 月 4 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币 2,500.00 万元(含),不超过 5,000.00 万元(含),回购价格不超过 34 元/股(含),回购的公司股份全部用于员工持股计划或股权激励。

截止 2023 年 3 月 31 日,公司累计回购公司股份 519.848 股,占公司总股本的 0.49%,支付的资金总额为 1,278.40 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),占截止 2023 年 3 月 31 日公司货币资金的 12.01%,占流动资产的 3.00%,占净资产的 1.50%。

鉴于公司拟将回购公司股份全部用于员工持股计划或股权激励,公司回购价格与授予价格的差额将会最终影响到公司未来现金流,假设公司按照回购成本的 50%授予员工,则预计最终对公司未来现金流的影响在 1,250.00-2,500.00 万元,占截止 2023 年 3 月 31 日货币资金的 11.74%-23.48%,占流动资产的 2.94%-5.87%,占净资产的 1.46%-2.93%,虽然占货币资金比重相对较高,但公司可以通过流动资产变现以及筹措资金等方式储备回购资金,回购整体对公司流动性和净资产影响较小,公司也不存在进行大额回购的情形,不会对公司生产经营造成重大影响。

公司将结合未来经营情况、现金流情况、股价情况、员工激励需要,稳妥推进股份回购进展,评估适当的最终回购数量,避免股份回购对公司生产经营造成重大影响,维护中小投资者的合法权益。

综上,公司进行股份回购具有合理原因,不存在过度消耗公司资金的情形。

保荐机构、会计师的核查结论:

1、公司有息负债的金额、利率、期限、到期日、借款对象、用途等信息真实、可靠。

2、公司不存在信用贷款的原因真实,具有合理性。

3、公司未来一年短期偿债能力较为稳定,公司资金流动性风险较低,整体可控。

4、公司在存在大额有息负债的前提下,进行股份回购的原因具有合理性。

四、关于存货

4.年报显示,2022 年末公司存货账面余额 1.3 亿元,同比增长 19.58%。其中,库存商品 3086 万元,同比增长 114%;低值易耗品 2467 万元,同比增长 25.14%。期末存货跌价准备余额 1691 万元,同比增长 226%。

请公司:(1)结合产销量情况、库存商品构成、库龄、订单覆盖情况,说明库存商品账面余额大幅增长的原因及合理性,产品是否存在滞销风险,如是,请补充披露并提示风险;(2)说明存货周转率下降的原因及合理性,与同行业可比公司是否存在明显差异;(3)列式低值易耗品的具体构成,说明未计提跌价准备的原因及合理性;(4)结合在手订单、存货可变现净值、库龄及周转周期等,详细说明存货跌价准备测算过程、存货跌价准备是否计提充分、与同行业可比公司是否存在重大差异。

公司回复:

(一)结合产销量情况、库存商品构成、库龄、订单覆盖情况,说明库存商品账面余额大幅增长的原因及合理性,产品是否存在滞销风险,如是,请补充披露并提示风险;

1、公司 2022 年度产销量情况

单位:万颗

产品名称	2022 年度产量	2022 年度销量	数量产销率
SOT	441,592.45	457,955.85	103.71%
DFN/QFN	116,288.34	115,908.14	99.67%
SOP	170,401.56	168,870.60	99.10%
CPC	33,717.54	34,231.39	101.52%
LQFP	3,659.57	3,864.75	105.61%
其他	59,190.76	38,095.60	64.36%
合计	824,850.22	818,926.33	99.28%

注:产销率=销量/产量

报告期内,公司库存商品的产销率较高,平均为 99.28%,库存商品根据销售需求生产,总体保持稳定。

2、公司期末库存商品构成、库龄情况

单位:万颗、万元

产品名称	数量	2022 年余额	占比	1 年以内	1-2 年	2 年以上
SOT	23,450.92	2,263.27	73.35%	2,231.42	29.95	1.90
DFN/QFN	2,806.27	320.06	10.37%	303.23	16.75	0.07
SOP	4,341.64	302.25	9.80%	298.96	3.25	0.05
CPC	337.27	19.56	0.63%	19.31	0.10	0.15
LQFP	59.85	17.53	0.57%	14.87	2.66	–
其他	2,032.22	162.93	5.28%	146.40	12.77	3.76
合计	33,028.17	3,085.60	100.00%	3,014.19	65.48	5.93

由上表可知,公司期末库存商品主要由 SOT、SOP、DFN/QFN、CPC 以及 LQFP 系列产品构成,金额合计 2,922.67 万元,占比 94.72%,其他产品 162.93 万元,占比 5.28%。

公司期末库存商品库龄情况如下:1 年以内金额 3,014.19 万元,占比 97.69%;1-2 年金额为 65.48 万元,占比 2.12%,2 年以上金额 5.93 万元,占比 0.19%。

3、公司的库存商品订单覆盖率

单位:万元、万颗

项目	数量	2022 年余额	有销售订单支持部分		无销售订单支持部分	
			金额	占比	金额	占比
库存商品	23,450.92	3,085.60	2,786.14	90.29%	299.46	9.71%
合计	23,450.92	3,085.60	2,786.14	90.29%	299.46	9.71%

公司期末库存商品有销售订单支持部分占比 90.29%,远高于无销售订单支持部分占比 9.71%,符合公司以销定产的经营模式。

综上,公司的库存商品的产销量情况、库存商品的构成、库龄以及库存商品的订单覆盖率情况均是正常的。

库存商品增加的原因一方面是由于自购芯片业务因 2022 年度市场行情变化,出货速度减慢,2022 年末余额为 794.54 万元,较 2021 年末余额增加 693.30 万元,截止至 2023 年 3 月末已销售出库 573.57 万元。另一方面是主要系部分客户因下游市场需求不足,相关客户根据自身库存情况,推迟了部分产品出库时间,其中主要客户 2022 年末余额为 597.60 万元,较 2021 年末余额增加 464.16 万元,截止至 2023 年 3 月末已销售出库 301.03 万元。此外,公司 2022 年四季度开发的个别新客户,因客户需求,在合同中约定交货期较长,封测好的库存商品 961.35 万元在 2022 年末尚未出货,截止至 2023 年 3 月末已销售出库 143.15 万元。

公司期末库存商品余额增长具有合理性,产品不存在滞销风险。

(二)说明存货周转率下降的原因及合理性,与同行业可比公司是否存在明显差异

报告期内,公司存货周转率情况如下:

指标	2022 年度	2021 年度
存货期初余额(万元)	10,870.78	8,134.94
存货期末余额(万元)	12,998.91	10,870.78
主营业务成本(万元)	51,846.42	54,240.22
存货周转率(次)	4.34	5.71
存货周转期(天)	84.10	63.92

由表中分析可知,公司 2022 年度存货周转率较上年度下降 1.36 次,降幅为 23.89%,下降的主要原因如下:

1、2022 年度整体封测市场行情不景气,导致客户出货速度放缓;

2、公司期末存货余额较期初增加 2,128.13 万元,增加比例 19.58%。增加的存货主要类别库存商品和低值易耗品,其中:库存商品增加 1,643.73 万元;低值易耗品增加 495.51 万元。库存商品增加的原因一方面是由于自购芯片业务因 2022 年度市场行情变化,出货速度减慢,2022 年末余额为 794.54 万元,较 2021 年末余额增加 693.30 万元,截止至 2023 年 3 月末已销售出库 573.57 万元。另一方面是由于部分客户因下游市场需求不足,客户根据自身库存情况,推迟了部分产品出库时间,其中的主要客户 2022 年末余额为 597.60 万元,较 2021 年末余额增加 464.16 万元,截止至 2023 年 3 月末已销售出库 301.03 万元。此外,公司 2022 年四季度开发的个别新客户,因客户需求,在合同中约定交货期较长,封测好的库存商品 961.35 万元在年末尚未出货,截止至 2023 年 3 月末已销售出库 143.15 万元;低值易耗品的增加主要为备件品类增加,2022 年 12 月 31 日备件余额较 2021 年 12 月 31 日备件余额增加 436.62 万元,增加比例 31.10%。增加的原因系公司大量购置固定资产-机器设备,随之备用的备件类相应的增加。

综上,公司存货周转率下降系受下游市场需求影响,具有合理性。

公司存货周转率与同行业上市公司比对结果如下:

项目	2022 年存货周转率
长电科技	8.06
华天科技	4.31
通富微电	6.26
甬矽电子	5.58
晶方科技	3.81
平均值	5.60
气派科技	4.34

报告期内,公司的存货周转率与同行业上市公司华天科技接近,低于甬矽电子、长电科技和通富微电,高于晶方科技,与几家公司的平均存货周转率接近,不存在明显差异。

(三)列式低值易耗品的具体构成,说明未计提跌价准备的原因及合理性

公司截至 2022 年 12 月 31 日低值易耗品的具体构成情况如下表:

序号	名称	数量(件、颗、千克)	金额(万元)
1	备件	97,694.00	1,840.69
2	辅材	1,314,973.50	215.08
3	刀片	4,605.00	106.01
4	劈刀	31,353.00	90.04
5	金手指	823.00	67.61
6	吸嘴	20,585.00	61.11
7	探针	22,276.00	55.89
8	测试座	311.00	21.75
9	顶针	3,545.00	8.35
总计		1,496,165.50	2,466.53

注:表中数量存在 0.5,其单位是千克。

由上表可知,公司 2022 年末低值易耗品主要以机器设备备件、辅材、刀片等耗材组成,其中机器设备备件占比 74.63%,占比最大。公司机器设备备件为未计提跌价准备的原因在于公司机器设备备件单位价值较高,主要用于设备维修和维护,通过维持设备正常运行来实现价值。设备备件可长期储备,使用价值不会因为库龄增加而下降。

公司辅料及刀片、劈刀等耗材具有数量多,单位价值较低的特点,主要用于公司封装测试产品,该类低值易耗品周转速度较快,利用率高,因此公司对该类低值易耗品未计提存货跌价准备。经查询同行业可比公司 2022 年年度报告,通富微电和华天科技存货类别划分与公司不一致,无存货-低值易耗品的分类;长电科技的存货类别划分与公司相同,未见其对期末低值易耗品计提存货跌价准备。

公司的低值易耗品市场价格方面无大幅下跌,不存在长期积压无法使用、损坏等存在减值情形的迹象,因此公司基于上述原因未对期末低值易耗品计提存货跌价准备,符合会计核算的重要性原则,具备合理性。

(四)结合在手订单、存货可变现净值、库龄及周转周期等,详细说明存货跌价准备测算过程、存货跌价准备是否计提充分、与同行业可比公司是否存在重大差异

截至 2022 年期末,公司主要存货的订单覆盖情况如下所示

项目	存货余额	有销售订单支持的部分		无销售订单支持的部分	
		金额	金额占比	金额	金额占比
原材料	4,678.95	481.36	10.29%	4,197.59	89.71%
库存商品	3,085.60	2,786.14	90.29%	299.46	9.71%
低值易耗品	2,466.54	479.35	19.43%	1,987.20	80.57%
在产品	1,928.18	1,905.00	98.80%	23.18	1.20%
发出商品	839.29	839.29	100.00%		
委托加工物资	0.34	–	–	0.34	100.00%
合计	12,998.91	6,491.14	49.94%	6,507.76	50.06%

公司 2022 年期末,有订单支持的金额为 6,491.14 万元,订单覆盖率为 49.94%,其中原材料订单覆盖率为 10.29%,库存商品订单覆盖率为 90.29%,低值易耗品订单覆盖率为 19.43%,在产品订单覆盖率为 98.80%,发出商品订单覆盖率为 100.00%。

1)库存商品订单覆盖率 90.29%,在产品订单覆盖率为 98.80%,订单覆盖率较高,库存商品及在产品无销售订单支持的部分,均为自购芯片产品。

2)报告期末原材料的订单覆盖率为 10.29%,订单覆盖率较低,主要原材料按照生产物料计划进行备货,库存量一般控制在 1 个月左右的消耗量,而公司客户提供的待排产订单一般约为 7 到 10 天生产量,故以期末在手未投产订单数量计算的所需材料定义为有订单支持的材料时,无订单支持的材料比例较高。公司主要原材料较大部分为通用材料,不存在因后续订单产品品类变化而导致无法使用的情况,为公司合理备货。

3)低值易耗品订单覆盖率为 19.43%,各期末低值易耗品主要由设备备件、刀片、金手指、辅材及吸嘴等构成,公司低值易耗品主要为设备备件,占低值易耗总额的 74.63%,为满足生产机器设备使用需求的合理配置。

报告期期末,公司存货的库龄情况如下:

单位:万元

分类	账面余额	1 年以内	1 年以上
原材料	4,678.95	3,217.09	1,461.86
库存商品	3,085.60	3,014.19	71.41
在产品	1,928.18	1,928.18	–
低值易耗品	2,466.54	1,300.64	1,165.91
发出商品	839.29	664.95	174.34
委托加工物资	0.34	–	0.34
合计	12,998.91	10,125.05	2,873.86
占比	100.00%	77.89%	22.11%

公司存货主要集中在 1 年以内,占 77.89%,1 年以上占比 22.11%,总体成新率较高,不存在因存货积压或滞销导致存货异常变动的情形。

库龄一年以上的原材料金额为 1,461.86 万元,其中:引线框 1,382.95 万元,占比 94.60%。该部分原材料的库龄较长的原因是由于 2021 年度市场行情较好,业绩同比大幅增长,因此增加了引线框、丝材等主要原材料备货量。2022 年,受宏观经济环境变化、行业周期波动等因素影响,集成电路行业整体增速放缓,公司订单量不及预期,导致库龄一年以上的引线框等原材料较多。2022 年末公司已根据可变现净值与成本孰低的原则以及库龄情况对引线框等主要原材料充分计提了减值准备。

库龄一年以上低值易耗品金额为 1,165.91 万元,其中:备件 984.31 万元,占比 84.42%。该部分低值易耗品的库龄较长的原因是由于随着募投项目及自有资金扩产项目快速实施,公司在 2021 年度和 2022 年度大量购置机器设备,与机器设备配套使用备件增加备货。备件无保质期,长期存放并不影响正常使用,减值风险较低。

报告期期初、期末,公司存货跌价准备计提情况如下:

单位:万元

项目	账面余额	存货可变现净值	存货跌价准备
原材料	4,678.95	3,972.02	706.93
在产品	1,928.18	1,623.43	304.75
库存商品	3,085.60	2,734.93	350.67
发出商品	839.29	510.92	328.37
合计	10,532.03	8,841.30	1,690.73

由上表可知,公司存货跌价为 1,690.73 万元,主要为原材料跌价 706.93 万元,占原材料账面余额的 15.11%,在产品跌价 304.75 万元,占在产品账面余额的 15.80%,库存商品跌价金额为 350.67 万元,占库存商品账面余额的 11.36%,发出商品跌价 328.37 万元,占发出商品余额的 39.12%,对公司各存货可变现净值计算过程分别进行说明如下:

1)库存商品可变现净值的确定方法及计算过程

报告期末公司的库存商品对于有订单部分的库存商品可变现净值以订单价格作为预计售价,对于无订单支持部分的库存商品以最近一次销售价格作为预计售价,再减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

2)发出商品可变现净值的确定方法及计算过程

报告期末公司的发出商品可变现净值以发出商品对应订单价格作为预计售价,减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

3)原材料可变现净值的确定方法及计算过程

对库龄较长的原材料结合能否正常使用进行跌价测算,如判断为原材料完全无法使用的,全额计提跌价准备,对判断为库龄较长原材料后续可以使用的,根据存货价值的 80%及可变现净值孰低计提。

对于可正常使用的原材料在资产负债表日,按正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,按照原材料成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4)在产品可变现净值的确定方法及计算过程

公司在产品可变现净值确认按正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

注:销售费用=成品售价*(销售费用/营业收入)、相关税费=成品售价*(税金及附加/营业收入)

公司与同行业可比公司的存货跌价准备计提比例对比情况如下:

单位:万元

公司	账面余额	存货跌价准备	计提比例
华天科技	232,346.33	6,969.10	3.00%
通富微电	358,833.22	11,164.41	3.11%
长电科技	351,783.41	36,609.39	10.41%
晶方科技	16,656.64	5,658.44	34.00%
甬矽电子	32,470.08	412.79	1.00%
同行业平均比例			10.30%
气派科技	12,998.91	1,690.73	13.01%

由上表可见,经与同行业对比公司存货跌价准备计提比例比较,公司存货跌价准备计提比例较高于同行业,体现了公司存货跌价准备计提的充分性、谨慎性。

保荐机构、会计师的核查结论:

1、公司期末库存商品余额大幅增长具有合理性,产品不存在滞销风险;

2、公司存货周转率下降与 2022 年度封测市场行情不景气有关,具有合理性,与同行业上市公司不存在明显差异;

3、公司未对期末存货低值易耗品计提存货跌价准备的原因真实,符合会计核算的重要性原则,具有合理性;

4、公司存货跌价准备政策合理,存货跌价准备计提充分。

五、关于募投项目

5.年报显示,公司募集资金投资项目之一为高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目,截止报告期末累计投入进度 93.70%,项目建成后将新增年封装产能 16.1 亿只。除募集资金扩产项目外,公司还存在自有资金扩产项目。募集资金投资项目之二为研发中心(扩建)建设项目。截止报告期末累计投入 685 万元,累计投入进度为 34.23%,项目达到预定可使用状态日期为 2023 年 6 月。

请公司:(1)列式公司自有资金扩产项目的具体产品及产能规划、总投资金额、投资进度及工程进度、预计达产时间等;(2)结合产品的市场空间、竞争格局、在手订单、产能利用率、下游客户验证进展、新增产能情况,说明公司募集资金及自有资金扩产项目是否存在产能消化风险及公司的应对措施;(3)说明募投项目及自有资金扩产项目投产后,相关折旧、摊销等费用对公司财务状况的影响;(4)补充披露研发中心(扩建)建设项目的具体进展,是否在延期风险。

公司回复:

(一)列式公司自有资金扩产项目的具体产品及产能规划、总投资金额、投资进度及工程进度、预计达产时间等

鉴于 2020 年、2021 年集成电路行业景气度高,公司分别于 2020 年 12 月、2021 年 7 月备案了“小型化有引脚芯片封装和测试生产线技术改造项目”“小型先进集成电路(芯片)装测试生产未改造项目”两项技改扩产项目,2021 年,随着行业景气度越来越高,公司部分设备老旧,产能低,公司或需补充新设备提升公司产能以满足客户的需求,因此,公司对两个项目进行了备案变更,增加了投资额,具体情况如下表所示:

项目	产品	产能规划	计划总投资金额(万元、含税)	截止 2022 年底投资金额(万元、含税)	截止 2022 年底投资进度	预计达产时间
小型化有引脚芯片封装和测试生产线技术改造项目	QFN/DFN、MEMS、LQFP、SOP、SOT	10 亿只	22,000.00	12,681.39	57.64%	2024 年 6 月
小型先进集成电路(芯片)装测试生产未改造项目	QFN/DFN、MEMS、LQFP、SOP、SOT	15 亿只	27,841.00	27,022.03	97.06%	2023 年 12 月

(二)结合产品的市场空间、竞争格局、在手订单、产能利用率、下游客户验证进展、新增产能情况,说明公司募集资金及自有资金扩产项目是否存在产能消化风险及公司的应对措施

1、长期来看,封测行业市场空间依然广阔

虽然半导体产业在 2022 年已遇到挑战,出现周期性波动,但发展的长期基本面仍然保持强劲。2022 年以来全球各国持续强化半导体政策支持力度,晶圆厂纷纷宣布扩产计划。根据浙商证券统计数据显示,2022 年中国大陆共有 23 座 12 英寸晶圆厂正在投产,总计月产能约为 104.2 万片,与总规划月产能 156.5 万片相比,产能装载率仅达到 66.58%,仍有较大扩产空间。预计中国大陆 2022 年-2026 年还将新增 25 座 12 英寸晶圆厂,总规划月产能将超过 160 万片。预计截至 2026 年底,中国大陆 12 英寸晶圆厂的总月产能将超过 276.3 万片,相比目前提高 165.1%。国内头部晶圆厂逆势扩产,将为下游封测带来发展机遇。

2022 年全球集成电路封测市场规模超过 733 亿美元,较 2021 年增长 7.2%。根据中国半导体行业协会数据统计,中国封测市场规模由 2017 年的 1889 亿元增至 2021 年的 2763 亿元,年均复合增长率约为 9.9%,据赛迪顾问预测,预计到 2025 年,中国大陆集成电路封装测试行业销售额将超过 4,200 亿元,封测市场依然存在增长机遇。

2、封测行业集中度总体较高,传统封装竞争较为激烈,先进封装领域具有广阔的市场前景,目前,公司逐步在先进封装领域布局发力,发展潜力较大

从全球市场来看,封装测试行业市场形成了集中度较高且较为稳定的竞争格局,行业前十大企业由中国台湾、中国大陆和美国企业所占据,近年来全球前十大企业市场份额达到 75%以上。我国集成电路封测行业属于市场化程度较高的行业,也是中国大陆集成电路发展最为完善的板块,技术能力与国际先进水平比较接近,长电科技、通富微电、华天科技均进入全球封测企业前十。

当前半导体行业部分应用领域需求出现了周期性波动,市场竞争激烈,头部企业客户群相对丰富、需求领域多元化,在市场变化时可以利用其品牌优势、规模优势、资金优势、渠道优势等获取客户订单,业绩波动相对较小。以气派科技为代表的第二梯队封测企业,虽具备一定的竞争优势,但与头部企业相比优势不足,综合实力尚需进一步提升。

由于先进封装领域具有广阔的市场前景,公司顺应行业趋势,并逐步在先进封装领域布局发力,先进封装收入占比稳步提升,发展潜力较大。目前,随着公司募投项目和自有资金扩产项目的投产,产能规模短时增长较快,短期内产能消化承压,产能消化将存在一定风险。

长期来看,我国半导体国产替代的背景没有发生改变,集成电路封装测试行业市场容量巨大,预计 2025 年超过 4,200 亿元,公司的产能规模相较于整个集成电路封测行业需求的占比较小,未来仍然具备广阔的市场机遇,能够为气派科技这类内资封装测试企业提供足够的市场空间。气派科技在集成电路封装领域具有较强的成本控制和质量管理优势,是国内封装测试技术应用型代表企业之一,是华南地区封装品类最为齐全的内资封装企业之一,公司在产品质量、交货期、专业服务等方面赢得了众多客户的认可,建立了自身的竞争优势和市场影响力,公司将抓住国产替代机遇,进一步提升自身的竞争地位,助力公司实现产能消化。

3、在手订单以及下游客户验证进展

2022 年 12 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日,气派科技在手订单情况如下:

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动数量/金额	变动比例
在手订单数量(万颗)	88,852.45	68,712.28	20,140.17	29.31%
在手订单金额(万元)	5,420.30	4,222.49	1,197.81	28.37%
平均单价(元/颗)	0.0610	0.0615	−0.0004	−0.73%

由上表可知,2023 年 3 月末相比于 2022 年末在手订单数量增加 20,140.17 万颗,增加比例为 29.31%;订单金额增加 1,197.81 万元,增加比例为 28.37%。公司积极促进销售,在手订单数量及金额均有所增加。

近年来,公司持续加强技术研发力度,不断提高封测产品品质,加快了下游客户的验证进展,为扩产后的产能消化进行了充分准备。公司具备先进的封测技术储备、稳定可靠的产品良率和良好的客户服务能力,持续推进新客户开发,与潜在客户进行商务洽谈,积极配合知名客户及其供应链完成前期产品开发、打样验证,进行各种性能测试、可靠性测试、制程测试等,并完成小批量生产、量产等验证环节。

2021 年以来,公司新通过验证的知名客户有中国电子科技集团公司第十三研究所、青鸟消防(002960)、敦泰电子(3545.TW)、中科蓝讯(688332)、国民技术(300077)、思瑞浦(688536)、中颖电子(300327)、赛微微电(688325)、中电华大科技(0085.HK)、通嘉科技(3588.TW)、虹冠电子(3257.TW)、兆易创新(603986)、通嘉科技(深圳)有限公司、深圳智芯微电子科技有限公司、华灿光电(300323)、钰太科技(6679.TW)等。受半导体行业周期性波动的影响,公司与新增下游客户的交易金额尚小,在报告期内对公司收入提升相对有限,但为公司长期产能消化奠定了充足的客户储备,为公司可持续增长提供了坚实的基础。

4、新增产能以及产能利用率

公司募集资金预计新增产能 16.1 亿只/年,自有资金扩产项目新增产能 25 亿只,随着募投项目和自有资金扩产项目的陆续投产,公司的产能规模进一步扩大,2022 年,半导体封测市场需求有所放缓,公司 2022 年度产能利用率为 68%。

5、产能消化风险及其应对措施

针对公司可能存在的产能消化风险,已在 2022 年度报告中“四、风险因素”之“(四)经营风险”补充披露如下:

“产能消化风险

随着公司募集资金项目的逐步建成和自有资金扩产的逐步实施,将有效提升公司半导体封装